

证券代码：688798
转债代码：118065

证券简称：艾为电子
转债简称：艾为转债

公告编号：2026-020

上海艾为电子技术股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）41,800,000股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币150,058,795.06元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行账户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金2,378,884,423.11元，其中以前年度累计使用募集资金1,827,235,012.00元，本年度使用募集资金551,649,411.11元，截至2025年12月31日止，本公司募集资金账户余额为79,317,168.95元，具体情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年8月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	320,104.40
其中：超募资金金额	56,712.42
减：直接支付发行费用	16,578.26
二、募集资金净额	303,526.14
减：	
以前年度已使用金额	182,723.50
本年度使用金额	55,164.94
暂时补流金额	36,257.90
现金管理金额	33,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.54
项目结项结余资金利息补充流动资金	34.62
加：	
募集资金利息收入	12,091.08
三、报告期期末募集资金余额	7,931.72

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2020年9月24日经本公司第三次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月15日更新了《管理制度》，并于2023年5月11日经本公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2024年1月16日再次更新了《管理制度》，并于2024年2月5日经本公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年7月29日再次更新了《管理制度》，并于2025年8月14日经本公司2025年第一次临时股东大会审议通过。同时，公司及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于2021年8月10日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年6月30日与招商

银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年10月31日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年11月2日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年11月3日与中国银行上海市吴中路支行、中信银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2024年5月24日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2025年1月23日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于2025年9月18日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-047），公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，原保荐人中信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，公司及保荐人中信建投证券与中国银行股份有限公司上海市闵行支行、上海银行股份有限公司市南分行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年8月10日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海艾为电子技术股份有限公司	招商银行上海分行营业部	121928744310666	128.32	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	12.56	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	7,210.20	使用中

上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行上海市吴中路支行	439081861450	25.60	使用中
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行闵行支行	03004644696	472.57	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	上海银行闵行支行	03004644378	17.55	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	中信银行上海分行营业部	8110201012101685873	1.68	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	上海银行闵行支行	03005501767	12.46	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	中国银行上海市吴中路支行	446885714103	2.47	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121939323310118	48.30	使用中
成都艾为微电子科技有限公司	上海银行闵行支行	03005824825	-	使用中
无锡艾为集成电路技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824795	-	使用中
苏州艾为集成电路技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824817	-	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824787	-	使用中
上海艾为集成电路技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121941213410012	-	使用中
上海艾为半导体技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121939330310013	-	使用中
深圳艾为集成电路技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121944966010017	-	使用中
合肥艾为集成电路技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121945865310018	-	使用中
哈尔滨艾为微电子技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121953529210020	-	使用中
大连艾为微电子技术有限公司	招商银行上海分行营业部	411910565110021	-	使用中
北京艾为微电子技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121980045910022	-	使用中
合计			7,931.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照

表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材耗、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。2025年度本公司用募集资金置换先期投入的金额为408,290,580.01元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月16日，本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2025年8月8日止，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金60,000万元全部归还至募集资金专户。

2025年8月12日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2025年12月31日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为362,579,046.92元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间		2021年8月10日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
60,000	2024年8月16日	12个月	2024年8月16日	2025年8月8日	60,000
36,658	2025年8月12日	12个月	2025年8月12日	2025年9月29日	400

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月16日，本公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变更改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币13亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2025年8月12日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变更改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为335,000,000.00元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年8月10日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
130,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2024年8月16日	2025年8月15日	2024年8月16日
90,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2025年8月12日	2026年8月11日	2025年8月12日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021年8月10日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行	结构性存款	存款	1,000	2025/9/23	2026/3/23	2026/3/23	1,000	1.65%	/
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行	结构性存款	存款	5,300	2025/10/16	2026/4/15	2026/4/15	5,300	1.65%	/
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行	结构性存款	存款	4,800	2025/11/6	2026/2/4	2026/2/4	4,800	1.55%	/

上海艾为电子技术股份有限公司	中信证券	节节升利系列4248期收益凭证	收益凭证	1,500	2025/12/12	/	可随赎回T+1到账	1,500	1.4%-1.85%	/
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行	结构性存款	存款	4,000	2025/12/23	2026/1/26	2026/1/26	4,000	1.5%	/
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行	结构性存款	存款	9,000	2025/12/23	2026/3/23	2026/3/23	9,000	1.65%	/
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行	结构性存款	存款	2,000	2025/12/30	2026/2/2	2026/2/2	2,000	1.5%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	中信证券	节节升利系列4285期收益凭证	收益凭证	5,900	2025/12/30	/	可随赎回T+1到账	5,900	1.45%-1.65%	/

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年8月12日，第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已完成并达到预定可使用状态。截至2025年8月7日，“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”的节余募集资金合计为21,043.78万元，截至2025年8月28日止，公司已将结余募集资金扣除已

签订合同待支付款项968.20万元后的20,075.57万元用于投入到“高性能模拟芯片研发和产业化项目”，以满足市场需求及公司研发目标，提高公司募集资金使用效率。

在相关募集资金专户注销前，“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；待节余募集资金投入“高性能模拟芯片研发和产业化项目”事项完成且募集资金专户注销后，剩余待支付款项将以自有资金支付。节余募集资金全部转出完毕后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。保荐人出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日止，“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已签订合同待支付款项尚未支付完毕，募集资金专户尚未注销。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021年8月10日				
节余募集资金合计金额			20,075.57				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
智能音频芯片研发和产业化项目、	3,330.70	用于募投项目	高性能模拟芯片研发和产业化项目	66,783.59	66,783.59	2025年8月12日	/
5G射频器件研发和产业化项目	5,657.15	用于募投项目	高性能模拟芯片研发和产业化项目	66,783.59	66,783.59	2025年8月12日	/

马达驱动芯片研发和产业化项目	11,087.72	用于募投项目	高性能模拟芯片研发和产业化项目	66,783.59	66,783.59	2025年8月12日	/
----------------	-----------	--------	-----------------	-----------	-----------	------------	---

（七）募集资金使用的其他情况

2025年1月16日，本公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海艾为集成电路技术有限公司、上海艾为半导体技术有限公司、深圳艾为集成电路技术有限公司、合肥艾为集成电路技术有限公司、哈尔滨艾为微电子有限公司、大连艾为微电子有限公司、北京艾为微电子有限公司作为募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”、“高性能模拟芯片研发和产业化项目”及“发展与科技储备资金”的实施主体。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2025年7月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，在募投项目金额不变的情况下，公司拟将高压BCD先进工艺导入投资金额由6,500万元变更为14,000万元，基于RiscV架构的SoC平台投资金额由4,800万元变更为2,000万元，电荷泵快充和光学防抖的技术开发由8,700万元变更为4,000万元。“发展与科技储备资金”项目使用募集资金投资总额保持不变，达到预定可使用状态的时间延长至2026年8月。保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。

2025年8月12日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》。在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后，拟将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，艾为电子2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了艾为电子2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：艾为电子2025年度募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026年4月10日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 8 月 10 日										
本年度投入募集资金总额			55,164.94										
已累计投入募集资金总额			237,888.44										
变更用途的募集资金总额			40,280.57										
变更用途的募集资金总额比例			13.27%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能音频芯片研发和产业化项目	研发项目	否	44,164.59	40,833.88	40,833.88	7,217.33	42,832.98	1,999.10	104.90	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
5G 射频器件研发和产业化项目	研发项目	否	21,177.05	15,519.91	15,519.91	2,915.11	16,734.78	1,214.88	107.83	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
马达驱动芯片研发和产业化项目	研发项目	否	36,789.12	25,701.40	25,701.40	5,006.19	27,864.67	2,163.27	108.42	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	生产建设	是	40,824.76	20,619.76	20,619.76	-	21,892.29	1,272.53	106.17	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
电子工程测试中心建	生产建设	是	73,858.20	94,063.20	94,063.20	13,626.38	70,760.15	-23,303.05	75.23	2026 年 3 月	不适用	不适用	否

设项目													
发展与科技储备资金	研发项目	是	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,872.53	23,099.84	-6,900.16	77.00	2026年8月	不适用	不适用	否
超募资金	回购股份	不适用	56,712.42	10,004.40	10,004.40	-	10,004.40	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
高性能模拟芯片研发和产业化项目	研发项目	是	-	66,783.59	66,783.59	17,527.39	24,699.32	-42,084.27	36.98	2027年12月	不适用	不适用	否
合计			303,526.14	303,526.14	303,526.14	55,164.94	237,888.44	-65,637.70					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			详见说明三(七)										
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司不存在项目可行性发生重大变化的情形										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见说明三(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见说明三(三)										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见说明三(四)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不存在										
募集资金结余的金额及形成原因			详见说明三(六)										
募集资金其他使用情况			详见说明三(七)										

注1:智能音频芯片研发和产业化项目、5G射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目及研发中心建设项目:四个项目截至期末累计投资金额都超过承诺投资金额,投入进度超过100%,皆系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注2:高性能模拟芯片研发和产业化项目:调整后募集资金承诺投资总额不含首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 8 月 10 日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
电子工程测试中心建设项目	电子工程测试中心建设项目	生产建设	94,063.20	94,063.20	13,626.38	70,760.15	75.23	2026 年 3 月	不适用	不适用	否	2023 年 10 月 26 日	2023 年 11 月 14 日
研发中心建设项目	研发中心建设项目	生产建设	20,619.76	20,619.76	-	21,892.29	106.17	2023 年 10 月	不适用	不适用	否	2023 年 10 月 26 日	2023 年 11 月 14 日
发展与科技储备资金	发展与科技储备资金	研发项目	30,000.00	30,000.00	8,872.53	23,099.84	77.00	2026 年 8 月	不适用	不适用	否	2025 年 7 月 27 日	/

高性能模拟芯片研发和产业化项目	高性能模拟芯片研发和产业化项目	研发项目	66,783.59	66,783.59	17,527.39	24,699.32	36.98	2027年12月	不适用	不适用	否	2025年8月12日	/
合计			211,466.55	211,466.55	40,026.31	140,451.60							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位。公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益，用于“电子工程测试中心建设项目”。</p> <p>公司分别于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，使用募集资金拟投入金额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-053）。</p>										
			<p>2025年7月27日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整，公司拟加大对55nm和40nmBCD先进工艺导入的投入。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目子项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-035）。</p>										
			<p>2025年8月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，“高性能模拟芯片研发和产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为2026年6月，该项目包括高性能电源管理芯片产品开发和信号链芯片产品开发，项目产品具有种类多、范围广、部分品类开发专业性门槛高等特点，随着细分市场竞争加剧，公司需要更多的时间分析最新市场需求，根据需求进一步升级迭代产品，以更好的适应市场变化，优化资源配置。同时，“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”的节余募集资金200,755,731.09元投入“高性能模拟芯片研发和产业化项目”后，可以支撑公司高性能模拟芯片的后续研发投入和升级迭代。在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后，将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。</p>										

<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>2024年4月8日，本公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》，因外部环境变化，公司无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟，亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致并联征询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求，设计单位重新对施工图进行调整修改，建设规模超过原先体量，项目新增设计两层地下室，整体施工周期增加，并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审，导致项目建设周期拉长，本项目投产时间也将随之顺延，董事会同意对“电子工程测试中心建设项目”将原计划达到预定可使用状态日期2024年8月延期至2026年3月。</p> <p>2025年7月27日，本公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整，公司拟加大对55nm和40nmBCD先进工艺导入的投入，根据对未来投入规划的测算，将募投项目延期至2026年8月，以实现募投项目建设基础平台性及前瞻性的技术的目标。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目子项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-035）</p> <p>2025年8月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，“高性能模拟芯片研发和产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为2026年6月，在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后，将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司不存在项目可行性发生重大变化的情形</p>